

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称： 年研发及加工芯片 200 万片项目
建设单位（盖章）： 无锡晶驰半导体科技有限公司
编制日期： 2026 年 5 月

中华人民共和国生态环境部制